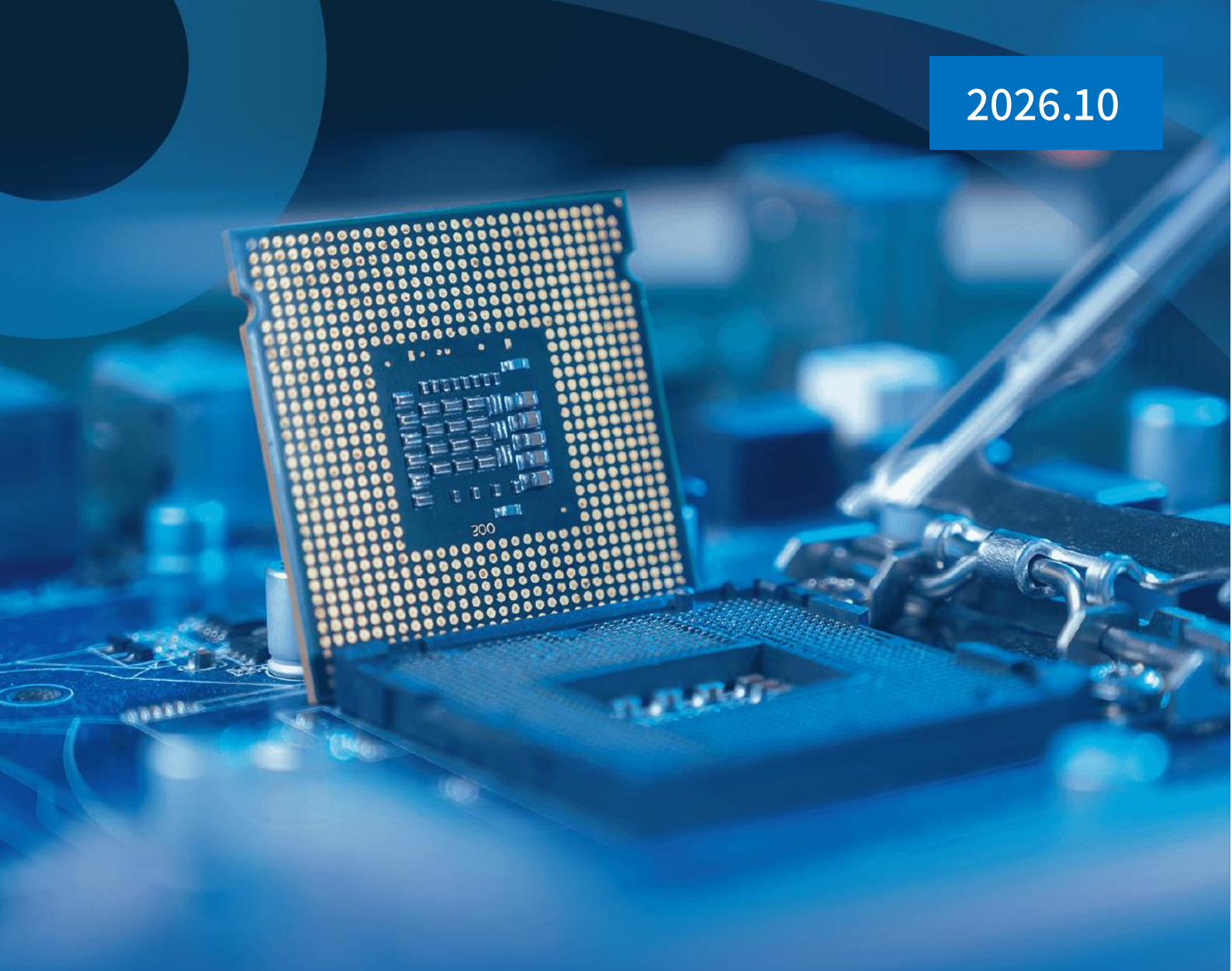
2026.10



电子元器件销售行情分析与预判

华强电子网集团
Huaqiang Electronic Network Group

芯八哥

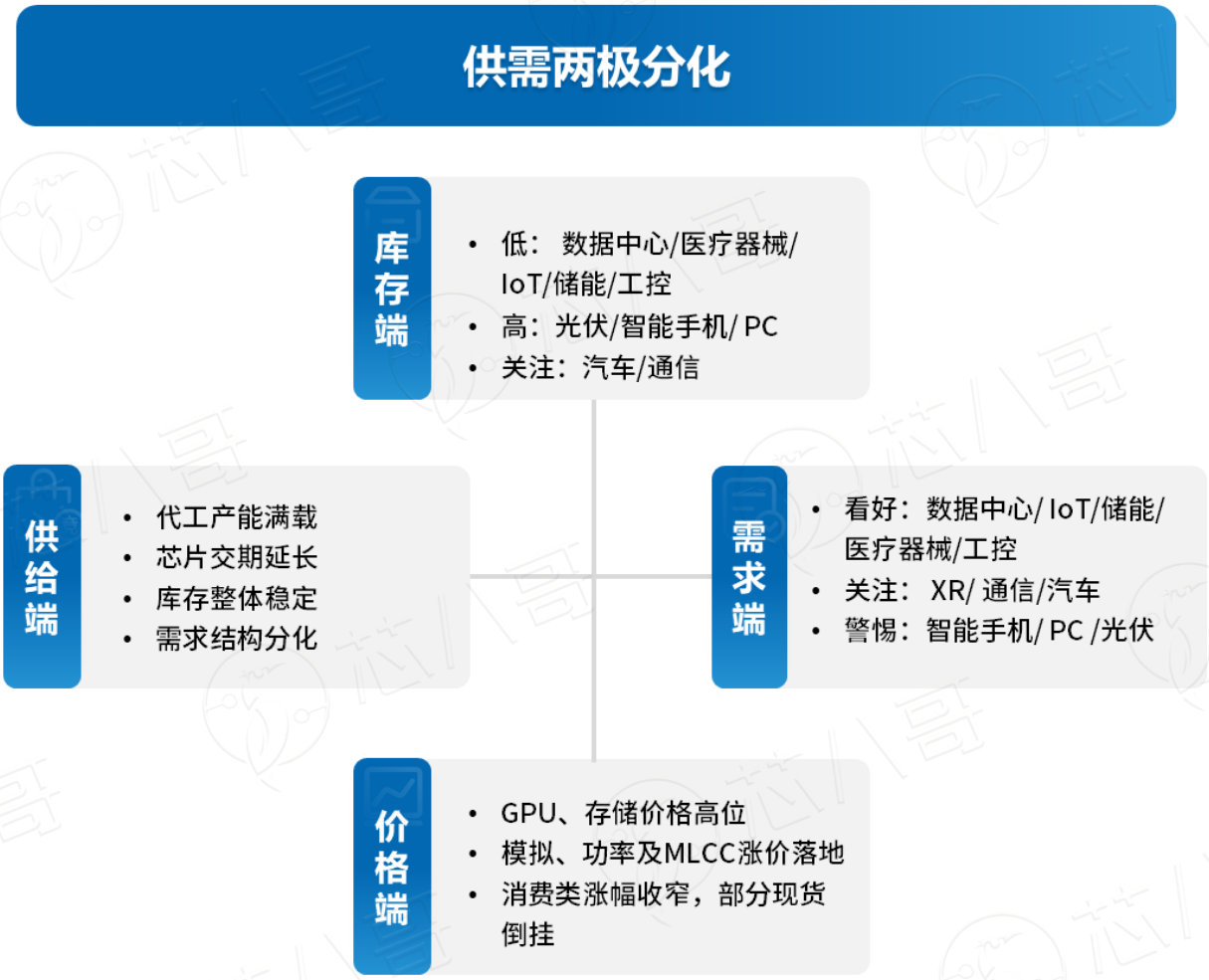
正文目录

序章 1
一、宏观经济 1
1、全球制造业扩张放缓，分化格局加剧 1
2、电子信息制造业增长提速，效益向好 2
3、半导体销售再创新高，区域景气各异 3
二、芯片交期趋势 5
1、整体芯片交期趋势 5
2、重点芯片供应商交期一览 6
三、订单及库存情况 17
四、半导体供应链 19
1、半导体上游厂商 19
（1）硅晶圆/设备 19
（2）原厂 20
（3）晶圆代工 23
（4）封装测试 24
2、分销商 24
3、系统集成 25
4、终端应用 30
（1）消费电子 30
（2）新能源汽车 31
（3）工控 33
（4）光伏 34
（5）储能 35
（6）数据中心 36
（7）通信 38
（8）医疗器械 39
五、分销与采购机遇及风险 40
1、机遇 40
2、风险 41
六、小结 42
免责声明 43

图表目录

图表 1：全球主要经济体制造业 PMI.....2
图表 2：最新中国电子信息制造业运行情况.....2
图表 3：最新全球半导体行业销售额及增速.....3
图表 4：最新全球及中国集成电路产量及增速.....4
图表 5：最新中国集成电路进出口金额及增速.....4
图表 6：费城及申万半导体指数走势.....5
图表 7：芯片交期趋势.....5
图表 8：主要厂商交期及趋势一览.....6
图表 9：头部企业订单及库存情况.....17
图表 10：半导体设备及硅晶圆头部企业订单情况.....19
图表 12：主要原厂最新动态.....20
图表 12：主要晶圆代工厂最新动态.....23
图表 13：主要封测厂商最新动态.....24
图表 14：主要元器件分销商最新动态.....25
图表 15：主要系统集成商最新动态.....26
图表 16：消费电子厂商最新动态.....30
图表 17：新能源汽车厂商最新动态.....32
图表 18：工控厂商最新动态.....33
图表 19：光伏厂商最新动态.....35
图表 20：储能厂商最新动态.....36
图表 21：数据中心厂商最新动态.....37
图表 22：通信厂商最新动态.....38
图表 23：医疗器械厂商最新动态.....39
图表 24：细分市场机会关注.....40
图表 25：细分市场风险预警.....41

序章

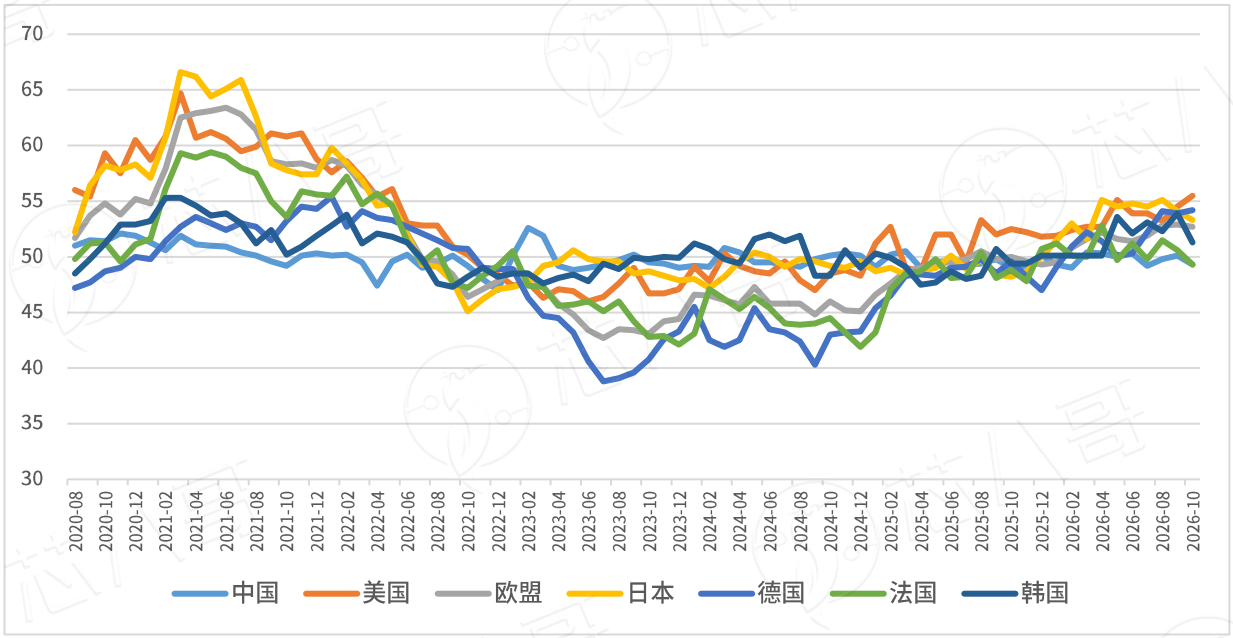


一、宏观经济

1、全球制造业扩张放缓，分化格局加剧

10 月，从各国表现看，美国、德国延续扩张，中国季节性回落但仍处结构调整期、高技术制造保持活跃，法国跌回收缩，日韩增速放缓，区域分化进一步凸显。

图表 1：全球主要经济体制造业 PMI

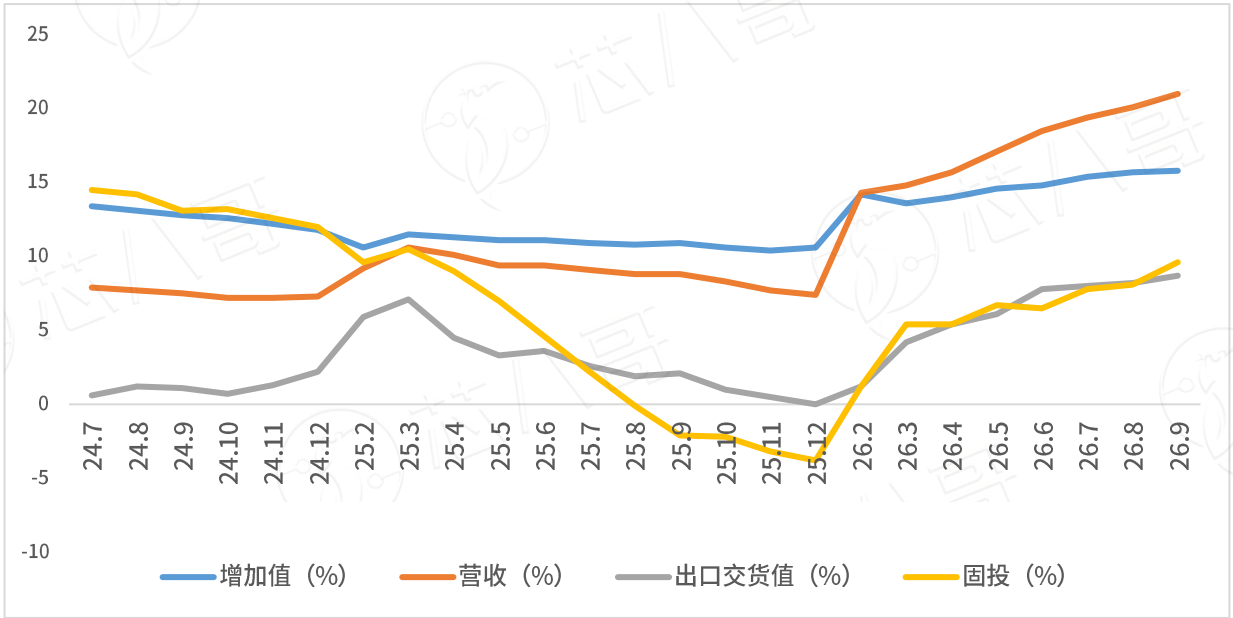


资料来源：国家统计局、芯八哥整理

2、电子信息制造业增长提速，效益向好

2026 年前三季度，中国我国电子信息制造业生产增长较快，出口持续上行，效益增势突出，投资继续增长，地区间营收分化明显。

图表 2：最新中国电子信息制造业运行情况



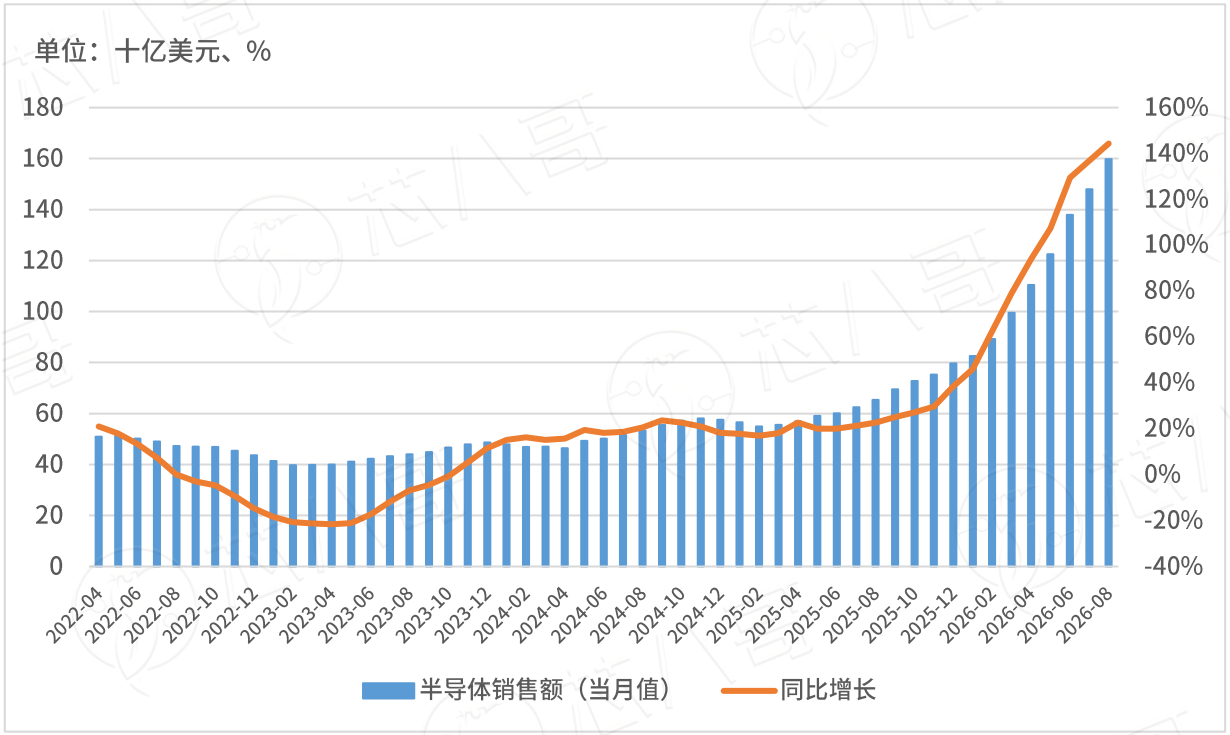
资料来源：工信部

3、半导体销售再创新高，区域景气各异

根据 SIA 最新数据，9 月全球半导体市场销售额达 1725.8 亿美元，同比增长 146.8%，连续第 19 个月实现环比增长，2026Q3 销售额达 5177 亿美元。

区域市场方面，美洲市场同比增长 191.7%，中国市场同比增长 124.9%，亚太地区、日本和欧洲销售额分别为 141.4%、73.4%、102.5%。

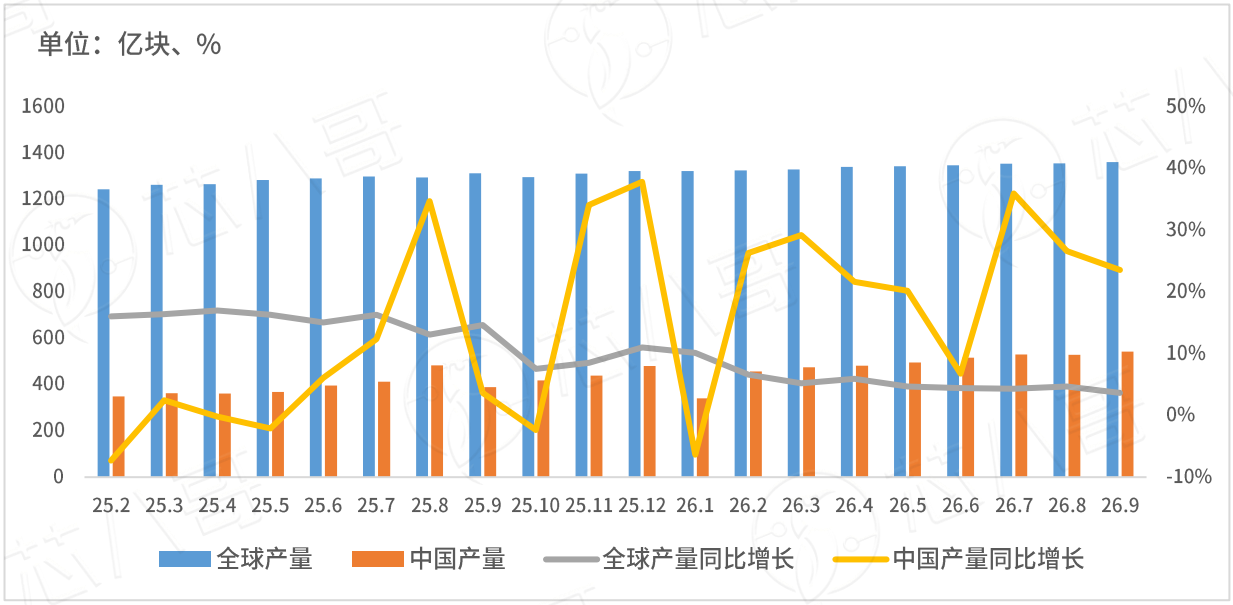
图表 3：最新全球半导体行业销售额及增速



资料来源：SIA、芯八哥整理

从集成电路产量看，9 月全球与中国集成电路产量分别约 1361、542.7 亿块，供给端持续放量。

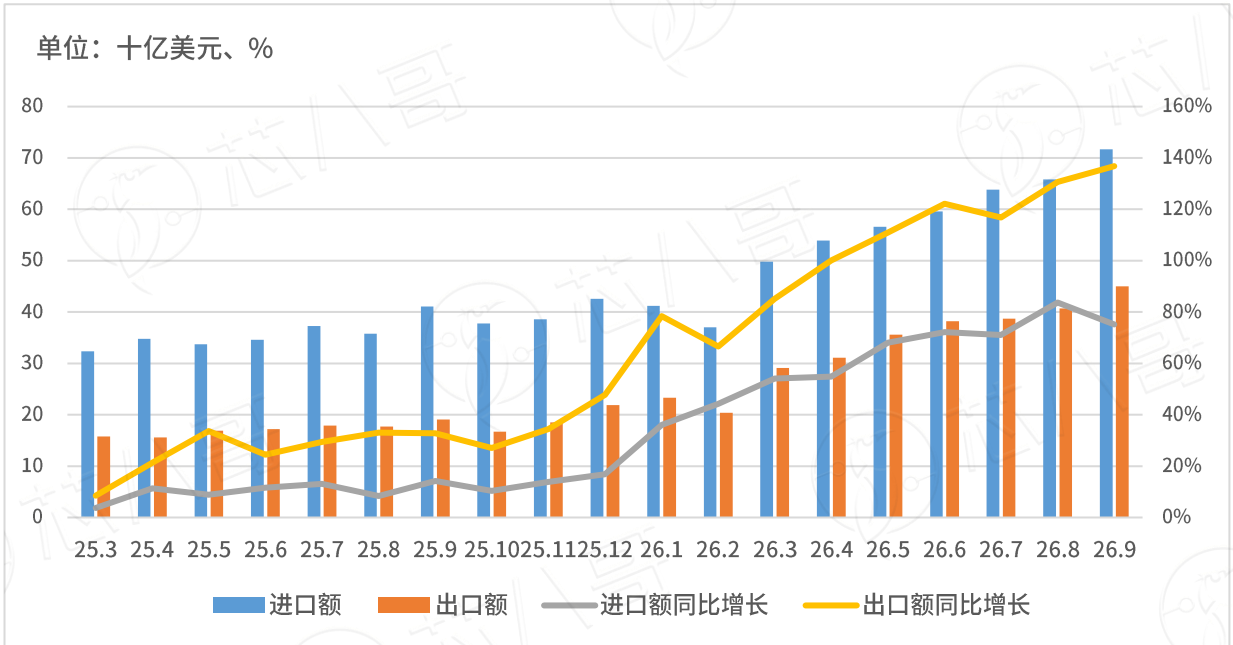
图表 4：最新全球及中国集成电路产量及增速



资料来源：国家统计局、CSIA、SIA、芯八哥整理

进出口方面，9 月中国集成电路贸易保持强劲，出口增速超 136%，国产替代深化。

图表 5：最新中国集成电路进出口金额及增速

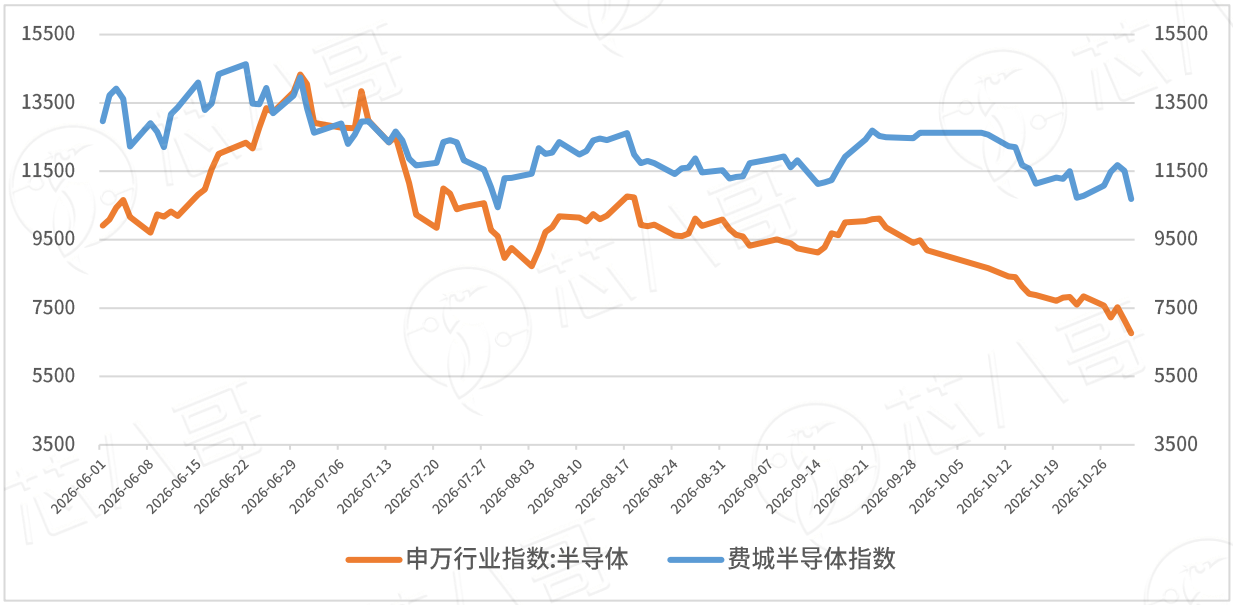


资料来源：工信部、CCD、芯八哥整理

从资本市场指数来看，10 月费城半导体指数（SOX）下跌 15.3%，中国半导体（SW）

业指数下滑 22.5%，前期涨幅过大，估值高位回调。

图表 6：费城及申万半导体指数走势



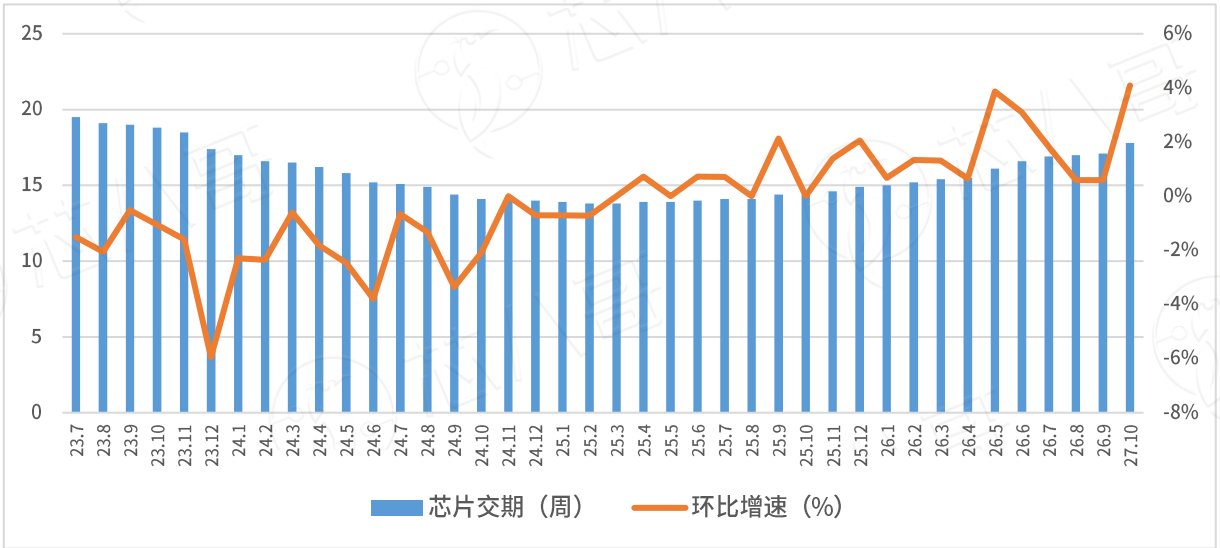
资料来源：Wind

二、芯片交期趋势

1、整体芯片交期趋势

10 月，元器件交期加速上扬，供给端偏紧格局延续。

图表 7：芯片交期趋势



资料来源：芯八哥整理

2、重点芯片供应商交期一览

展望 11 月，行业结构性紧缺进一步加剧，模拟（TI、ADI 等）、射频无线、功率器件、存储及高端被动元件交期普遍再拉长、价格延续上行。MCU、FPGA 及部分消费料分化明显，交期回稳、现货市场出现倒挂。

图表 8：主要厂商交期及趋势一览

类别	供应商	产品	26.10 交期/周	26.11 交期/周	交期趋势	价格趋势
模拟	TI	多源模拟/电源	16-30	20-48	延长	上升
		信号链	16-24	16-45	延长	上升
	AMS OSRAM	传感器	16-40	16-40	延长	上升
	BOSCH	传感器	16-52	16-20	延长	稳定
	Diodes	多源模拟/电源	18-40	18-40	延长	上升
		开关稳压器	20-24	16-40	延长	上升
	FTDI Chip	接口	30-34	30-34	延长	上升

类别	供应商	产品	26.10 交期/周	26.11 交期/周	交期趋势	价格趋势
	Infineon	传感器	4-60	4-60	延长	上升
		开关稳压器	24-30	30-52	延长	上升
		汽车模拟和电源	24-30	24-30	延长	上升
	ADI（Maxim）	信号链	26-40	26-52+	延长	上升
		接口	26-40	26-52+	延长	上升
		开关稳压器	26-40	26-52+	延长	上升
	Microchip	信号链	4-10	4-10	稳定	上升
		定时	7-12	7-12	稳定	上升
		开关稳压器	8-16	8-16	稳定	上升
	MPS	开关稳压器	24-46	24-52	延长	上升
	NXP	传感器	16-52	16-52	稳定	稳定
		接口	16-20	16-20	稳定	上升
		汽车模拟和电源	22-24	22-24	稳定	上升

类别	供应商	产品	26.10 交期/周	26.11 交期/周	交期趋势	价格趋势
	onsemi	传感器	18-52	18-52	延长	上升
		信号链	10-16	10-16	稳定	上升
		定时	22-32	22-32	稳定	上升
		多源模拟/电源	14-26	14-26	延长	上升
		开关稳压器	12-22	12-22	延长	上升
	Panasonic	传感器	16-26	16-26	延长	上升
	Renesas	信号链	14-16	14-16	延长	上升
		定时	20-26	20-26	延长	上升
		接口	12-14	12-14	延长	上升
		开关稳压器	18-36	36-50	延长	上升
	ROHM	传感器	24-52	24-52	延长	上升
		开关稳压器	16-26	16-26	延长	上升
	ST	传感器	24-52	24-52	延长	上升
		信号链	20-22	28-30	延长	上升

类别	供应商	产品	26.10 交期/周	26.11 交期/周	交期趋势	价格趋势
		多源模拟/电源	18-26	30-36	延长	上升
		开关稳压器	18-26	30-52+	延长	上升
		汽车模拟和电源	18-30	30-52+	延长	上升
	TE	传感器	16-52	16-52	延长	上升
	Vishay	传感器	24-52	24-52	稳定	稳定
射频和无线	Infineon	蓝牙模块	16-24	16-24	稳定	上升
	Microchip	WiFi 模块	12-20	25-30	延长	上升
		蓝牙模块	12-20	25-30	延长	上升
		收发器/接收器	12-20	12-20	稳定	上升
	Murata	WiFi 模块	26-50	26-50	延长	上升
		蓝牙模块	26-50	26-50	延长	上升
	Laird	WiFi 模块	16-30	16-30	稳定	稳定

类别	供应商	产品	26.10 交期/周	26.11 交期/周	交期趋势	价格趋势
		天线	12-16	12-16	稳定	稳定
	ST	蓝牙模块	52	52	延长	上升
		收发器/接收器	30	30	延长	上升
		RFID	20	28	延长	上升
	NXP	收发器/接收器	24	24	稳定	上升
		RFID	13	26	延长	上升
		大功率 IC	12-16	12-16	稳定	上升
	onsemi	蓝牙模块	16-30	16-30	稳定	稳定
分立器件	Diodes	低压 MOSFET	12-52	12-52	延长	上升
		TVS 二极管	16-40	16-40	延长	上升
		桥式整流器	16-20	26-52	稳定	稳定

类别	供应商	产品	26.10 交期/周	26.11 交期/周	交期趋势	价格趋势
		肖特基二极管	20-50	35-52	延长	上升
		整流器	24-30	26-52	稳定	稳定
		开关二极管	20-50	35-52	延长	上升
		小信号 MOSFET	20-50	35-52	延长	上升
		齐纳二极管	20-50	35-52	延长	上升
		双极晶体管	20-50	35-52	延长	上升
		数字晶体管/RETS	20-50	35-52	延长	上升
		通用晶体管	20-50	35-52	延长	上升
		逻辑器件	8-44	35-52	延长	上升
	Infineon	低压 MOSFET	12-52	8-52+	延长	上升

类别	供应商	产品	26.10 交期/周	26.11 交期/周	交期趋势	价格趋势
		高压 MOSFET	12-52	12-52+	延长	上升
		IGBT	12-52	14-52+	延长	上升
		宽带隙 MOSFET	12-52	18-52+	延长	上升
		数字晶体管/RETS	30-52	30-52	延长	上升
		通用晶体管	30-52	30-52	延长	上升
		军用-航空晶体管	16-24	16-24	稳定	稳定
	ST	低压 MOSFET	10-23	13-26	延长	上升
		高压 MOSFET	12-26	15-52	延长	上升
		IGBT	14-24	20-28	延长	上升
		ESD	16-24	16-40	延长	上升

类别	供应商	产品	26.10 交期/周	26.11 交期/周	交期趋势	价格趋势
		宽带隙 MOSFET	20-32	20-36	延长	稳定
		晶闸管 /Triac	15-20	15-20	稳定	上升
		TVS 二极管	12-16	18-24	延长	上升
		整流器	18-20	20-22	延长	稳定
		双极晶体管	22-36	22-36	延长	上升
	Wingtech（Nexperia）	低压 MOSFET	13-52	13-52+	延长	上升
		ESD	52	18-52	延长	上升
		肖特基二极管	16-52	16-52	延长	上升
		开关二极管	16-52	16-52	延长	上升
		小信号 MOSFET	16-52	16-52	延长	上升

类别	供应商	产品	26.10 交期/周	26.11 交期/周	交期趋势	价格趋势
		齐纳二极管	16-52	16-52	延长	上升
		双极晶体管	16-52	16-52	延长	上升
		数字晶体管/RETS	16-52	16-52	延长	上升
		通用晶体管	16-52	16-52	延长	上升
		逻辑器件	8-24	8-52	延长	上升
MCU	Renesas	8 位 MCU	18	18	延长	稳定
		32 位 MCU	18	18	延长	稳定
		汽车	24	24	稳定	稳定
		32 位 MPU	12	12	稳定	稳定
	ST	8 位 MCU	40-52	40-52	延长	稳定
		汽车	40-52	40-52	稳定	稳定
		32 位 MCU	40-52	40-52	延长	稳定
	Infineon	8 位 MCU	10-26	10-26	稳定	稳定
		32 位 MCU	10-97	10-97	延长	稳定

类别	供应商	产品	26.10 交期/周	26.11 交期/周	交期趋势	价格趋势
		汽车	32-45	32-45	稳定	稳定
	Microchip	8 位 MCU	4-12	4-12	稳定	上升
		32 位 MCU	4-18	4-18	延长	上升
		32 位 MPU	4-20	4-20	稳定	上升
	NXP	8 位 MCU	16-39	16-39	延长	上升
		32 位 MCU	16-39	16-39	延长	上升
		汽车	18-52	18-52	延长	上升
		32 位 MPU	18-52	18-52	延长	上升
可编程逻辑器件	AMD (Xilinx)	FPGA	18-30	18-30	稳定	上升
	Intel (Altera)		14-30	14-30	稳定	稳定
	Lattice		12-36	12-36	稳定	稳定

类别	供应商	产品	26.10 交期/周	26.11 交期/周	交期趋势	价格趋势
	Microchip（Microsemi）		12-30	12-30	延长	上升
存储器	Infineon	SRAM	12-52	12-52	延长	稳定
		NOR FLASH	20-26	22-52	延长	上升
	GigaDevice	NOR FLASH	16-26	24-26	延长	上升
		NAND FLASH	16-26	26-30	延长	上升
	Micron	DRAM	26-52	26-52	延长	上升
		eMMC	26-52	26-52	延长	上升
	SK Hynix	NAND flash	52+	52+	延长	上升
		eMMC	52+	52+	延长	上升
	Murata	滤波器	24-30	52	延长	上升

类别	供应商	产品	26.10 交期/周	26.11 交期/周	交期趋势	价格趋势
被动元件		电感/变压器	8-12	30-36	延长	上升
		引线陶瓷电容	26-30	30-36	延长	稳定
		专用电容	20-26	26-30	延长	稳定
	TDK	滤波器	24-26	30-32	延长	稳定
		电感/变压器	16-20	16-20	稳定	上升
		表面贴装通用陶瓷电容（车规级）	24-26	30-48	延长	稳定

资料来源：富昌电子、Wind、芯八哥整理

三、订单及库存情况

展望 11 月，头部厂商订单预期上行，库存维持低位，结构性紧缺延续。

图表 9：头部企业订单及库存情况

公司	26.10 订单	26.10 库存	26.11 订单预测	26.11 库存预测
Intel	上升	低	上升	低
AMD	上升	低	上升	低
NVIDIA	上升	无	上升	无
Samsung	上升	低	上升	低
TI	上升	一般	上升	一般
ST	上升	一般	上升	一般
ADI	上升	一般	上升	一般
Qualcomm	上升	低	上升	低
Broadcom	上升	低	上升	一般
NXP	上升	一般	上升	低
Infineon	上升	一般	上升	较低
Renesas	上升	低	上升	一般
onsemi	上升	低	上升	低
Microchip	上升	一般	上升	一般
Micron	上升	低	上升	低
SK Hynix	上升	低	上升	低

公司	26.10 订单	26.10 库存	26.11 订单预测	26.11 库存预测
Murata	上升	低	上升	低
MTK	上升	低	上升	低

注：高>较高>一般/稳定>较低>低>无

资料来源：芯八哥整理

四、半导体供应链

设备和材料订单延续上升，代工产能稳定，原厂订单强劲，终端需求分化。

1、半导体上游厂商

（1）硅晶圆/设备

设备和材料订单订单持续走高，头部厂商产能供不应求。

图表 10：半导体设备及硅晶圆头部企业订单情况

类型	企业	26.10 订单	26.10 库存	26.11 订单预测
设备	ASML	上升	低	上升
	AMAT	上升	低	上升
	泛林	上升	低	上升
	TEL	上升	低	上升
	科磊	上升	低	上升
	北方华创	上升	低	上升

类型	企业	26.10 订单	26.10 库存	26.11 订单预测
	中微公司	上升	低	上升
	新凯来	上升	无	上升
硅晶圆	信越化学	上升	低	上升
	Sumco	上升	低	上升
	环球晶圆	上升	低	上升
	台胜科技	上升	低	上升
	合晶科技	上升	低	上升
	沪硅产业	上升	低	上升

资料来源：芯八哥整理

（2）原厂

存储与 AI 相关厂商订单供不应求，产能被长期锁定。

图表 12：主要原厂最新动态

厂商	10 月动态
Intel	预计 Q4 营收低于预期，受 PC 需求疲软和零部件供应短缺拖累
AMD	预计 2027 营收增速超 80%、数据中心占 80%以上，PC 出货两位数下滑
NVIDIA	洽谈收购开源模型初创 Reflection AI
TI	下半年模拟产品已小幅提价

厂商	10 月动态
Qualcomm	与华为达成多年期专利许可协议
Samsung	2027 年约 80%存储产能已被长协锁定
MTK	AI ASIC 量产在即
Broadcom	Truist 预计可产生最多 300 亿美元收入
ADI	完成 13.5 亿美元收购 Alif
ST	Q4 指引超预期，AI 数据中心需求成主要驱动力
Infineon	将建设全球首个 12 英寸氮化镓晶圆厂
NXP	目前约 80%订单交期超 16 周；2027 年 1 月起部分分销及直供产品线涨价
onsemi	完成 Codasip 低端 RISC-V 业务收购；拟 10 亿美元收购电源芯片初创公司 Ferric
Renesas	Q3 营收与毛利率均超公司计划，数据中心为最大动能
Microchip	收购抗辐射 MCU/MPU 供应商 VORAGO
SK Hynix	未来三年 DRAM 以及 HBM 产能产能近乎售罄，供不应求持续至 2030 年
Micron	2027 与 2028 年存储供需状况比 2026 年更紧张
Seagate	产能已锁定至 2028 年，部分云客户合约延伸至 2030 年
WD	AI 需求保持强劲
Marvell	初步确认拟 1150 亿美元收购 Lumentum

厂商	10 月动态
Wolfspeed	与 Infineon 扩大并延长碳化硅晶圆供应协议
Murata	未来 5 年投资 1 万亿日元（约 64 亿美元）扩产 MLCC
Rapidus	目标 2027 财年下半年启动 2nm 量产
SEMCO	MLCC 等被动件交期上调最高 52 周；AI 服务器 MLCC 累计订单超 5 万亿韩元
Taiyo Yuden	拟联合 TDK 开发面向 AI 服务器和物理 AI 应用的被动件产品
KIOXIA	未来六年与闪迪在日本投入逾 5 万亿日元扩产
旺宏	全年资本支出从 220 亿追加至 378 亿新台币，新增产能 2027H2 投产
国巨	单季营收连续七季创新高；标准品与特殊品需求强劲
南亚科	DDR4 需求仍强，Q4 ASP 预期持续上涨
华邦电	未来两年数据中心 DRAM 需求明确，消费端已受高价影响
闻泰科技	正实施供应链切换及国产产线导入爬坡，海外晶圆供应受限导致可交付料号不足
豪威	预计 2026Q4 毛利率约 29.44%-30.74%
兆易创新	MCU 业务全年前景向好；利基型存储整体仍将处于供应紧张的局面
长鑫存储	拟投资近 350 亿元建设技术研发项目及存储器晶圆后道测试基地；$4F^2$ DRAM 架构取得关键突破，预计 2026 年底推出 4F2 DDR5 RDIMM
长江存储	预计 NAND 供应紧张还将持续约三年

厂商	10 月动态
江波龙	DRAM/NAND 价格涨幅较前期明显收窄
君正股份	存储价格整体仍呈上涨趋势，NOR Flash 大容量产品持续涨价
中微半导体	产品出货量增加和价格上涨为核心驱动

资料来源：芯八哥整理

（3）晶圆代工

成熟制程全面满载，产能供不应求。

图表 12：主要晶圆代工厂最新动态

厂商	26.10 产能利用率	26.10 动态	26.11 订单预测
台积电	98%-100%	布局 3D DRAM 制造	上升
三星	80%-90%	预计 Q4 晶圆代工营收实现两位数百分比增长	上升
联电	85%-90%	2027 年产品平均售价将同比上升 10%	上升
中芯国际	95%-96%	因存储紧缺主动延后部分手机订单	上升
格芯	80%-90%	与台积电签署 20 亿美元五年期协议，为 CoWoS 提供硅中介层	上升
世界先进	85%-95%	Q4 订单仍有向上空间	上升

厂商	26.10 产能利用率	26.10 动态	26.11 订单预测
力积电	80%-90%	2027 年拟涨 10%-20%并通过长约锁量	上升
华虹	＞100%	部分产品订单量达产能的 1.5-2 倍	上升

资料来源：芯八哥整理

（4）封装测试

订单交期延长，涨价扩散。

图表 13：主要封测厂商最新动态

厂商	26.10 产能利用率	26.10 动态	26.11 订单预测
日月光	90%-95%	AI 先进封装报价涨幅超 20%	上升
台积电	100%	拟将 CoWoS 报价上调 10%-20%；封装交期延长至约 8 个月	上升
长电科技	85%-95%	产能利用率高位运行	上升
通富微电	90%-95%	在建工程较年初+98%，持续加码先进封装	上升
华天科技	85%-95%	部分存储封装及高端测试产能接近满载	上升
中小封测厂	75%-85%	整体报价上调	上升

资料来源：芯八哥整理

2、分销商

头部厂商业绩大幅冲高，算力、工业及车规是增长主线。

图表 14：主要元器件分销商最新动态

厂商	10 月动态
Arrow	2026Q3 营收 107.18 亿美元，同比+39%，单季营收创历史新高
Avnet	2026Q3 营收 107.18 亿美元，同比+81.7%，单季营收创新高
大联大	前三季累计营收 1.28 兆新台币（年增 72.5%），已达去年营收 1.28 倍
文晔科技	AI 需求延续强劲，工业、车用及 Future 业务同步复苏
Smith	TI 是公开市场需求最高的主动 IC 厂商，占比达 45%
中电港	算力、存储订单大幅增长，Q3 累计营收 1308.53 亿元，同比+192.41%
深圳华强	存储产品线出货大幅增长，服务器、数据中心电源客户销售增长
香农芯创	存储算力订单旺盛，AI 客户需求强劲
英唐智控	通用散单为主，国产芯片增量有限
商络电子	车规、工业被动、连接器订单向好
好上好	周转持续低位，消费品类严控备货
云汉芯城	国产器件订单增速快
力源信息	ST 拟终止与公司代理经销合作关系

资料来源：芯八哥整理

3、系统集成

超节点、汽车电子及机器人等领域国产替代加速，传统汽车 Tier1 加速重组。

图表 15：主要系统集成商最新动态

类别	厂商	10 月动态
消费电子	鸿海精密	消费电子和电脑需求较好
	华勤技术	预测今年手机销量略有下滑，但下滑速度低于行业速度
	龙旗科技	AI PC 进入快速放量期
	比亚迪电子	2026Q4 智能终端订单仍面临一定压力
	立讯精密	进入惠普游戏笔记本供应链
	歌尔股份	AI 穿戴业务环比改善
	纬创	PC 营收占比已降至不到 20%，Q4 出货预计双位数季减
	仁宝	PC 需求较弱
	广达	未看到 PC 需求有回温趋势
	和硕	2026Q3 PC 出货约 130 万台，低于 Q2 的 170-180 万台
	英业达	2026Q4 PC 出货将季减 4%-9%
汽车	博世	组织架构重组；分拆德国业务
	麦格纳	全年预期销售额 412–420 亿美元
	李尔	2026Q3 营收 57.73 亿美元（+2%），净利润 1.37 亿美元（+26%）
	佛瑞亚	照明业务整体受到行业大环境走弱影响下跌

类别	厂商	10 月动态
	Valeo	预计今年销售额为 200-210 亿欧元
	Aumovio	2026Q3 自动驾驶及出行事业群营收 21 亿欧元，同比-12%
	现代摩比斯	欧洲电动汽车零部件需求走强
	宁德时代	10 月动力排产小幅震荡
	博格华纳	2026Q3 营收 34.87 亿美元，同比-2.9%
	奥托立夫	中国本土车企收入占比持续提升
	采埃孚	2026Q3 北美市场增长强势，欧洲、亚太地区销售额保持平稳
	安波福	与兆易创新达成战略合作
	比亚迪电子	2026Q3 单季收入超百亿元，同环比均实现双位数增长
	德赛西威	西班牙智能工厂三条产线按计划完成搭建，并启动试产及样件交付
	立讯精密	汽车电子延续高增长态势
	均胜电子	前三季度累计新获定点项目预测全生命周期订单金额约 615 亿元
	华勤技术	前三季度汽车业务实现翻倍以上增长
	鸿海精密	拟 1150 亿日元收购三菱电机汽车零部件业务 50%股权
工控	ABB	与三菱电机成立低压配电合资公司
	霍尼韦尔	上调全年营收预期

类别	厂商	10 月动态
	西门子	战略投资 Skeleton Technologies，拓展数据中心产品组合
	施耐德	离散自动化表现较好，过程与混合自动化在部分市场仍偏弱
	伊顿	电气整体订单出货比稳定在 1.2
	台达电	前三季度 AI 相关营收占比已超 50%
	汇川技术	电机、仿生臂等产品已在部分头部客户实现批量交付，今年订单及收入规模可达千万级
	埃斯顿	连续 7 个季度国内工业机器人市场第一
	麦格米特	AI 电源业务自 Q1 批量发货后，交付逐步爬坡，目前订单充足
	埃夫特	智能机器人业务收入前三季度同比+38.09%，请同比+77.28%
	信捷电气	Q3 纺织、包装、印刷等行业订单出现部分小幅恢复
新能源	阳光电源	逆变器业务毛利率基本稳定
	天合光能	三季度组件价格国内下降，海外有一定的提升
	锦浪科技	2026 年储能逆变器出货预计达 40-50 万台，同比翻倍
	固德威	前三季度储能逆变器出货约 31 万台，Q3 出货约 13 万台，环比持平
	上能电气	印度、中东和非洲等其他新兴市场新增装机将贡献重要增长
	德业股份	海外储能需求维持高增

类别	厂商	10 月动态
	艾罗能源	新增市场产品售价相对较低
	禾迈股份	前三季度净亏损 2.82 亿元，同比亏损扩大
数据中心	鸿海精密	10 月 AI 服务器收入环比下滑
	纬创	AI 服务器业务维持逐季走升
	广达	服务器营收占比超过 80%
	华勤技术	2026Q3 数据业务营收 224.56 亿元（同比+228%），超节点产品收入 61.91 亿元
	比亚迪电子	预计 2026Q4 液冷有三个项目量产交付，2027 年收入达数十亿元
	立讯精密	短期季度增量主要来自于算力高速互联以及 AI 终端新产品
通信	菲菱科思	前三季度营收 16.15 亿元（同比+9.51%）
	星网锐捷	存货规模显著抬升，主要为上游芯片元器件备货
	共进股份	前三季度营收 80.39 亿元（同比+22.94%），订单增加明显
	剑桥科技	拟再投入 17.69 亿港元扩产光模块

资料来源：芯八哥整理

4、终端应用

（1）消费电子

存储成本持续上涨，加速行业洗牌与转型。

图表 16：消费电子厂商最新动态

类别	企业	10 月动态
智能手机	苹果	Apple 智能接入阿里千问
	三星	下调明年 OLED Galaxy A 系列手机出货目标至 1 亿部
	OPPO	全年出货预期下调超 20%，Q3 出货跌幅超 18%
	vivo	全年出货预期下调近 15%，Q3 出货量同比跌幅超 20%
	小米	全年出货预期下调超 20%，Q3 出货量同比跌幅超 30%
	传音	智能手机 ASP 上升明显
PC	联想	Q3 全球出货 1499.3 万台（同比-22.4%）
	惠普	主动放弃部分对价格敏感的低毛利消费级订单
	华硕	下半年国内 PC 价格已涨约 10%
	宏碁	前 10 月累计商用产品线营收+42.2%
	戴尔	内存受限可能持续长达四年
VR/AR	Meta	Q3 Reality Labs 营收 4.43 亿美元，运营亏损 41.29 亿美元

类别	企业	10 月动态
	三星	首款 AI 眼镜通过美国 FCC 认证
	苹果	研发重心转向 AR 智能眼镜与 AI 可穿戴设备
	雷鸟创新	10 月完成 D++轮融资
无人机	大疆	上半年海外营收约 120 亿元（同比+30%）
	航天彩虹	无人机业务海外收入占比超 42%，毛利率达 39.1%
	小鹏汇天	陆地航母交付阿联酋试运行
	极飞科技	预计 2026 年底或 2027 年海外收入占比有望超过四成
电动两轮车	九号	行业进入存量竞争阶段
	小牛电动	面临利润承压
	绿源	全年预估约 1400 万辆，较去年下行
	雅迪	2026Q3 公司出货量同比转正
3C 配套产品	安克创新	前三季度小充、储能、影音等均取得较优增速
	绿联科技	消费级 NAS 正借 AI 浪潮进入渗透率快速提升期
	海能实业	前三季度营收 27.44 亿元，同比+13.73%

资料来源：芯八哥整理

（2）新能源汽车

传统车企普遍承压，电动化进程提速。

图表 17：新能源汽车厂商最新动态

厂商	10 月动态
比亚迪	计划将巴西工厂产能提高一倍
特斯拉	2030 年前电动车产量目标增至 500 万辆
本田	计划从 2027 年起在华导入 Momenta 智驾和华为鸿蒙座舱
大众	拟冻结员工薪资至 2030 年；计划 2026 年在华推出 20 款新能源车
宝马	第六代动力电池在沈阳正式量产下线
奔驰	在华销量承压，已下调 2026 年业绩指引
丰田	拟 2030 年前将全部 50 款车型升级为软件定义汽车
福特	平价 UEV 平台实现规模化量产难度极大
Stellantis	希望与中国车企合作，提高欧洲产能利用率
通用	美国市场 Q3 电车销量同比暴跌 62%
现代	在华电动化订单较弱
上汽	1-10 月新能源汽车累计销量 164.7 万辆（同比+27.7%）
雷诺	2026Q3 欧洲电车销量同比+85%，电动车已占公司订单总量 40%
广汽	1-10 月新能源累计突破 50 万辆（同比+58.94%）
长安	10 月新能源汽车销量 140,576 辆（同比+17.97%）

厂商	10 月动态
吉利	10 月新能源首次单月销量突破 20 万辆，渗透率达 69.3%
奇瑞	计划使出口车辆 50%由海外工厂制造
理想	年内累计销量同比持续负增长，在新势力中表现相对弱势
零跑	连续第四个月交付超 10 万辆
小米	2027 年的销量目标定在 75-80 万台
赛力斯	高端新能源承压明显
蔚来	1-10 月累计交付 334,547 辆，同比+38.5%
小鹏	10 月交付 50,237 辆，创单月历史新高（同比+20%，环比+22%）
长城	整体销量承压

资料来源：芯八哥整理

（3）工控

传统巨头订单爆满且持续涨价，国产龙头加速替代。

图表 18：工控厂商最新动态

厂商	10 月动态
ABB	2026Q3 订单爆涨 40%，中国区实现增长
西门子	电气产品价格调整，最高涨 125%
伊顿	收购中压配电解决方案厂商 COL Group

厂商	10 月动态
施耐德	第三季度末订单积压再创新高，上调 2026 年全年财务目标
GE	收购德国高压零部件巨头 Trench Group
台达电	Q4 营收将优于 Q3，并计划在马来西亚槟城设厂
汇川技术	预计通用自动化业务四季度及明年仍会延续较好的景气度
埃斯顿	Q3 工业机器人交付破万台，核心零部件自主化率高达 95%
麦格米特	GB300 产品产能不断爬坡，订单充足
埃夫特	预计今年机器人销量突破 20000 台
信捷电气	2027 年海外业务有望成为重要增量
雷赛智能	已进入 80%以上人形机器人整机厂家供应体系；今年全年机器人相关业务订单规模预计在两三亿元之间
英威腾	伺服、PLC 为重点培育成长业务，目前占营收比重较小
宇树科技	人形机器人行业尚处商业化早期
特斯拉	人形机器人初期制造成本约 3 万美元/台

资料来源：芯八哥整理

（4）光伏

行业处于盈利修复与触底反弹阶段，头部厂商利润及均价企稳回升。

图表 19：光伏厂商最新动态

厂商	10 月动态
隆基绿能	组件端盈利水平目前在持续修复中
天合光能	预计 2027 年国内外光伏需求均会有所增长
通威股份	硅料、电池环节出货及均价有一定上涨
晶科能源	2027 年全球市场增速预计保持在 10%左右
晶澳科技	2027 年中国市场大概率持平或小幅增长
阿特斯	预计 2027 年全球光伏需求有望恢复稳步增长
东方日升	前三季度净亏损 14.17 亿元，同比亏损扩大
爱旭股份	2026Q3 ABC 组件满产满销，出货约 5.4GW
横店东磁	海外印尼产能受关税影响盈利仍有承压
协鑫集成	2026Q3 营收超 72 亿元，BC 组件已实现量产出货
钧达股份	2026Q3 电池片出货环比实现大幅增长

资料来源：芯八哥整理

（5）储能

行业行业需求旺盛，价格逐步企稳。

图表 20：储能厂商最新动态

厂商	10 月动态
Fluence	2026 财年营收指引下调至约 24 亿美元
阳光电源	储能系统价格总体处于相对稳定阶段
宁德时代	10 月储能排产延续向好趋势
特斯拉	2026Q3 储能部署 13.7GWh，同比+9.6%
阿特斯	前三季度储能系统销售约 9GWh，同比增长约 55%
盛弘股份	储能整体市场有所回暖
亿纬锂能	与 Fluence 签署 206GWh 五年框架协议，其中 2027 年承诺交付 16GWh（占 7.8%、估算收入约 54 亿元）
派能科技	前三季度储能产品销售量 5221MWh，同比+117.09%
上能电气	全年海外市场储能出货量有望达到 10GW
天合光能	2026 年储能业务发展态势良好，前三季度出货近 10GWh，海外销售为主

资料来源：芯八哥整理

（6）数据中心

算力供给全面紧缺，资本开支与订单能见度持续拉长。

图表 21：数据中心厂商最新动态

企业	10 月动态
OpenAI	布局机器人研发
DeepSeek	完成 1000 亿元融资
Anthropic	上半年营收 163 亿美元，未来算力承诺或达 7500 亿美元
Meta	今年资本开支上调至 1450 亿美元，营收及展望均超预期；拟募资 950 亿美元，加码 AI 基础设施与超级智能
Kimi	算力供给成为制约商业化扩张核心瓶颈
NVIDIA	洽谈收购开源模型初创 Reflection AI
亚马逊	云服务容量已售罄至 2027 年
甲骨文	首次在云平台引入谷歌 TPU 等竞品芯片，提供多元算力选择
微软	向约 6 万名员工开放自愿离职方案，AI 巨额投入挤压人力预算
谷歌	将投资 170 亿美元，在怀俄明州建设其首个数据中心
字节跳动	考虑扩大巴西数据中心项目
腾讯	与甲骨文签署 5 年 70 亿美元算力租赁协议
阿里巴巴	明确 2032 年前运营逾 20GW 全球数据中心容量目标（当前约 5-6GW）
浪潮	Q3 起订单向超节点切换，Q4 集中交付放量

企业	10 月动态
戴尔	AI 服务器积压订单达创纪录 950 亿美元
华为	10 月昇腾算力基础设施密集落地

资料来源：芯八哥整理

（7）通信

海外运营商聚焦 AI 网络升级与光纤建设，中国三大运营商算力集采与园区建设全面提速。

图表 22：通信厂商最新动态

企业	10 月动态
T-Mobile	与 AWS 合作开发 Kinetic Edge；AI 语音助手与 AI 驱动网络规划已落地
AT&T	Q3 先进连接互联网净增 76.9 万创纪录（含光纤 44.2 万）
Verizon	资本支出指引含 AI Connect 投入增加
Vodafone	完成收购德国光纤合资公司 OXG 50%股权
BT Group	Openreach 全光纤覆盖达 2340 万场所，季度净增 57.4 万创纪录
中国移动	启动 2026-2027 年 AI 超节点设备集采，平均单卡约 57 万元
中国联通	前三季度算力收入同比+12.2%（智算中心+10.4%）
中国电信	启动多项算力集采与园区建设，AIDC 招标预算 76.4 亿元

企业	10 月动态
中兴通讯	前三季度算力营收同比+70%，占总营收 38%；服务器及存储+70%，数据中心产品+近 130%
思科	2026 财年超大规模云 AI 基础设施订单 93 亿美元，已实现收入 40 亿美元
爱立信	AI 挤占导致存储芯片成本上涨，对明年毛利率构成压力
诺基亚	数据中心订单驱动利润超预期

资料来源：芯八哥整理

（8）医疗器械

外资巨头持续战略分拆聚焦核心主业，在华业绩持续承压。

图表 23：医疗器械厂商最新动态

企业	10 月动态
强生	2026Q3 医疗科技收入 262.04 亿美元（+4.9%），美国以外医疗器械业务面临下跌
美敦力	完成 MiniMed 集团分拆
西门子医疗	2026Q3 中国区营收同比-2%，影像与精准治疗在中国因集采和定价压力预计 2027 财年小幅下滑
波士顿科学	与 Heartflow 达成战略合作，推进 AI 驱动的 CT 引导 PCI 规划
飞利浦	2026Q3 影像引导治疗与精准诊断均双位数增长
雅培	2026Q3 营收 130.13 亿美元（+14.5%），医疗器械+6.9%

企业	10 月动态
GE 医疗	2026Q3 中国区收入 5.86 亿美元，同比+7.1%，占集团总收入约 10.63%
迈瑞医疗	预计今年国内业务实现增长
联影医疗	超高端产品商业化全面提速

资料来源：芯八哥整理

五、分销与采购机遇及风险

1、机遇

新能源车高渗透、L3 自动驾驶加速普及与农业无人机全球领先，关注供应链增量需求。

图表 24：细分市场机会关注

机会关注	影响	涉及行业	相关企业
中国新能源汽车月度销量占比连续三个月超 60%	利好新能源汽车供应链	新能源汽车等	比亚迪、宁德时代及华为等
预期 2030 年 L3 级自动驾驶渗透率将超过 35%	芯片、传感器、域控受益	自动驾驶	华为、豪威及德赛西威等
中国农用无人机保有量超 30 万架，居全球首位	利好农业智能化供应链	无人机等	极飞科技、大疆等

资料来源：芯八哥整理

2、风险

手机出货创 14 年新低、DRAM 价格持续大涨 20%挤压下游利润，叠加新能源车出口退税退坡及人形机器人尚处早期，供应链面临考验。

图表 25：细分市场风险预警

风险预警	影响	涉及行业	相关企业
26Q3 全球智能手机出货同比-20%，创 14 年来新低	手机芯片及零部件承压	智能手机等	手机品牌及芯片、零部件链等
新能源汽车增值税出口退税率由 13%下调至 9%	短期压制整车出口利润	新能源汽车	比亚迪、吉利、上汽等
宇树：人形机器人行业尚处商业化早期	谨慎评估机器人供应链	人形机器人	宇树、智元及特斯拉等
集邦：26Q4 DRAM 合约价环比涨 20%	DRAM 量价齐升延续	DRAM	Samsung、SK Hynix 及 Micron 等

资料来源：芯八哥整理

六、小结

10 月，半导体市场呈现上游产能紧缺与下游需求疲软的显著分化。消费电子受成本高企拖累，出货量创 14 年新低，部分元器件现货价格倒挂，资本市场半导体板块估值也出现高位回调。

展望 2027 年，AI 及存储需求仍将维持高景气，但需警惕成本上涨对下游利润的持续挤压。面对手机需求萎缩、新能源车退税下调及 DRAM 价格续涨等多重压力，建议对消费类客户严格执行按需采购并收紧账期，避免高价备货，防范下游需求萎缩引发的库存减值风险。

免责声明

本文由华强电子网集团旗下媒体芯八哥®内容团队整理，观点仅代表作者本人，芯八哥®对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。本刊提醒读者，本报告内容及观点仅供学习参考，不构成任何投资及应用建议，请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。

华强电子网集团旗下媒体芯八哥

2026 年 11 月

扫码关注“芯八哥”

及时获取更多半导体市场采购及销售情报、厂商动态和行业趋势报告

加入芯八哥半导体行业交流群

群内每日分享行业前沿资讯，还有精品报告、行业白皮书免费领取

华强电子网集团
Huaqiang Electronic Network Group
电子元器件产业互联网平台

华强电子网集团是一家面向电子元器件垂直产业链的产业互联网 B2B 综合服务商。公司以数字化为驱动，以平台化为方向，以“ 线上+线下 ” 相结合的 B 端运营服务能力为基础，为产业链参与者提供专业化的全球采购服务和综合信息服务，致力于为电子元器件供需双方建立高效连接，减少信息不对称，实现电子元器件产业链交易效率和客户服务水平的提升。

未来，华强电子网集团将通过与物流、资金流、信息流以及自身优势多元产业链的深层次合作和优势互补，围绕电子元器件及相关产品垂直应用领域，通过不断创新服务内容，进一步构建多层次、满足长尾采购需求的现货大生态，致力于打造世界级的电子元器件产业互联网平台。



更高效 更透明 重构产业生态
Restructure the Industrial Ecology More Efficiently and Transparently

华强电子网集团
Huaqiang Electronic Network Group

芯八哥

电子元器件产业互联网平台

www.hqengroup.com

更高效 更透明 重构产业生态

元器件采购 | 产品信息展示 | 仓储服务 | BOM工具
品牌推广 | SaaS | PCB制板